

**ADVANTEST**<sup>®</sup>

**MASK MVM-SEM**<sup>®</sup>

# E3640

1Xnm ノードフォトマスク対応の多次元観察・測長 SEM



ADVANTEST

「E3640」は、フォトマスクの微細パターン寸法を高精度で測定でき、さらに、3D計測・3D観察が可能で従来のCD-SEMの枠組みを超えたMVM-SEM\*です。マスク用SEM市場で広く支持されている当社「E3600シリーズ」の最新機種として、測定再現性とスループットを大幅に改善し、今後の量産工程への普及が見込まれる1Xnmノードのプロセスに対応しました。現在の半導体リソグラフィーの主流を占めるフォトマスクに加え、EUVマスクやNIL用テンプレートなどにもご利用いただけます。

\*: Multi Vision Metrology Scanning Electron Microscope  
(多次元観察・測長走査型電子顕微鏡)

## 測定対象

- 最先端フォトマスク
- EUVマスク
- ナノインプリント用テンプレート

## 1Xnmノードのプロセスをカバー

「E3640」は、新型電子光学レンズと信号処理系ハードウェアの一新により、当社従来機種に比べ測定再現性能が大幅に向上、次世代の1Xnmノードマスク・プロセス開発や生産評価が可能になりました。また、「E3600シリーズ」各機種のソフトウェアと完全互換のため、過去のソフトウェア資産を有効活用することができます。

## シミュレーション露光に対応

「E3640」は、フォトマスク上のパターン形状を元にウエハ上に出来上がるパターン形状を予測するシミュレーション露光アプリケーションとリンクすることで、マスクパターンの補正作業の効率を高めます。

## EDAツールとリンク

「E3640」はEDAツールとリンクし、測長したい場所の情報（座標やパターン形状）をEDAツールから取り込むことができます。これにより、ホットスポット（マスク側での補正が困難な微細かつ複雑なパターン）部分のより正確な測定が可能になり、マスク開発のスループットの向上に貢献します。

## 3D計測

当社従来機種である「E3630」と同様、マルチディテクタを搭載した構成と当社独自の計測アルゴリズムにより、パターンの幅、高さ、側壁角度をリアルタイムで3D観察および3D計測することができます。



- 本製品を正しくご利用いただくため、お使いになる前に必ず取扱説明書をお読み下さい。
- 本カタログ記載の製品仕様および外観等は、予告なしに変更することがありますのでご了承下さい。

MVM-SEMIは、(株)アドバンテストの日本、米国およびその他の国における登録商標または商標です。

**ADVANTEST®**

<https://www.advantest.com/>

株式会社 **アドバンテスト**

●お問い合わせは  
ナノテクノロジー事業本部  
〒349-1158 埼玉県加須市新利根1-5 埼玉R&Dセンタ  
TEL : 0480-72-6300  
E-mail : PDL-AT-info\_nano@advantest.com